

Компаунды эпоксидные тиксотропные, покровные, трудногорючие
Технические условия: УБ0.051.028 ТУ

Предназначены для защиты от внешних воздействий и герметизации изделий радиоэлектронной техники (в том числе полупроводниковой техники, интегральных микросхем) и электротехники, эксплуатирующихся в интервале температур $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха до 98% и рабочем напряжении до 50 кВ (в зависимости от конструктивных особенностей изделия).

- ЭК-93 – эпоксидная композиция на основе эпоксидной смолы ЭД-20, наполнителей и других добавок.
- Герметизация изделий осуществляется методом окунания.
- Затвердевание компаунда происходит при комнатной температуре.

Основные характеристики	
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее	
- при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$1 \cdot 10^{101}$ Ом·м
- при $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$	$5 \cdot 10^7$ Ом·м
- после выдержки в течение 1000 часов в условиях тропической влажности	$1 \cdot 10^7$ Ом·м
Тангенс угла диэлектрических потерь ($f = 10^3$ Гц), не более	
- при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,04
- при $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,10
- после выдержки в течение 1000 часов в условиях тропической влажности	0,13
Диэлектрическая проницаемость (при 106 Гц)	
- при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$	5
- при $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$	10,1
Влагопоглощение после 1000 часов испытаний в условиях тропической влажности	2,5%
Предел прочности при разрыве	30,0 МПа
Модуль упругости при разрыве	7400 МПа
Модуль упругости при изгибе	1870 - 2600 МПа
Коэффициент линейного расширения	$4,9 \cdot 10^{-5}$ 1/к
Усадка	1%
Жизнеспособность	3 ... 3,5 ч
Время отверждения	12 ч
Режим полимеризации	100/6 $^{\circ}\text{C}/\text{ч}$

Обозначение при заказе: Компаунд эпоксидный ЭК-93 УБ0.051.028 ТУ